

全自动PCB板选择性波峰焊

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 全自动PCB板选择性波峰焊 |
| 公司名称 | 深圳市科圣达超声波自动化设备有限公司 |
| 价格 | 350000.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市龙华新区大浪街道浪口二路92号3楼 |
| 联系电话 | 13823746941 |

产品详情

全自动PCB板选择性波峰焊也称选择焊，应用PCB插件通孔焊接领域的设备，因不同的焊接优势，在近年的PCB通孔焊接领域，有逐步成为通孔焊接的流行趋势，应用范围不限于：军工电子、航天轮船电子、汽车电子、数码相机、打印机等高焊接要求且工艺复杂的多层PCB通孔焊接。

全自动PCB板选择性波峰焊分为离线式选择性波峰焊和在线式选择性波峰焊两种

离线式选择性波峰焊：离线式即指与生产线脱机的方式，组焊剂喷涂机和选择性焊接机为分体式1+1，其中预热模组跟随焊接部，人工传输，人机结合，设备占用空间较小。

全自动PCB板选择性波峰焊实时接收生产线数据全自动对接，组焊剂模组预热模组焊接模组一体式结构，特点是全自动链条传输，设备占用空间较大，适合自动化要求较高的生产模式。

全自动PCB板选择性波峰焊优点：

一体化全功能性机型，整个运动平台上集成了喷雾及焊接，占地空间紧凑。

焊接质量高，大幅提升焊接的直通率。

模块化设计，SMEMA在线运输，支持客户进行灵活组线。

全电脑控制，参数均在电脑上设定与保存。生成配置文件，便于追溯与保存。

全自动PCB板选择性波峰焊分项说明：

机器软件系统：

拥有完全自主知识产权的选择焊软件，结合多年选择焊使用工艺，基于WINDOWS开发的软件功能，操作人性化与可追溯性良好。

可直接使用PCB图片或GERBER文档进行路径编程，路径起始点，焊接移动速度，空行程速度，Z轴高度，波峰高度等均可在电脑上设定。国产设备行业内唯一可以同时导入两种格式编程的软件。

全自动PCB板选择性波峰焊编制一块板的路径后，可通过阵列功能对拼板进行路径排列,同时可选择性的焊接治具上某些位置的PCB板。

焊接过程的实时显示。通过相机输送到电脑软件中，可对焊接过程进行拍照，录制视频及保存。

数据库功能。随着客户使用软件时间的增加，不断的添加焊锡及助焊剂的种类，针对每种产品生成的记录也越完善。可记录到焊接不同产品使用的助焊剂种类，焊锡种类，焊接参数，产品参数等。

关键参数的软件完全监控，比如温度，速度，空气压力，氮气压力等等。

升级为自动波峰高度校正功能。可设定间隔多少片板校正一次波峰高度。

升级为带MARK点定位及使用定位的频率。

全自动PCB板选择性波峰焊运动平台系统：

自主设计全铝铸造运动平台，轻量化的设计，提高运行速度的同时保证平台的刚性。

松下伺服驱动器与松下电机提供运动动力，上银滚珠丝杆与直线导轨进行导向，定位精确，噪音小，移动平稳。

移动平台带防尘板，防止脏物滴入到滚珠丝杆上。

全自动PCB板选择性波峰焊喷雾部份：

喷嘴采用日本原产雾化喷嘴，雾化效果好，并且不易堵塞，适合各种类型的助焊剂。可以升级选用德国原产喷射式喷嘴，仅适用于固体含量低于5%的助焊剂。

助焊剂采用压力灌贮存，保证喷雾压力恒定，不受助焊剂多少的影响。气压通过电子气压表反馈到电脑中进行监控，以确保喷雾的效果。

全自动PCB板选择性波峰焊预热部份：

运输上部配远红外射灯加热，位置可调。

加热比率可电脑调节。

全自动PCB板选择性波峰焊选择性锡炉部份

锡炉温度，氮气温度，波峰高度，波峰校正等均可电脑设定。

锡炉内胆为钛合金制，绝无渗漏。外置式发热板，热传递均匀。

锡炉均采用快速接头连线，进行锡炉更换时无需重新接线。

氮气在线加热装置，保证锡炉良好的润湿性以及减少氧化物产生。

锡炉配锡液位报警。

氮气气压在通过电子气压表反馈到电脑中进行监控，以确保氮气保护的效果。

全自动PCB板选择性波峰焊输送机构

前后导轨分别采用独立步进电机驱动。

采用不锈钢滚轮运输，运行顺畅，长期使用无磨损。同时保证锡炉喷嘴可以达到PCB的板边3MM处。

运输导轨上配夹板机构，确保定位准确。

机器壳体：

整机钢结构，底部加基板以增加机器稳定性，减少震动。

机器表面工业烤漆。

全自动PCB板选择性波峰焊输送参数：

PCB宽度（mm）：30-350（拼板生产30-165）

PCB长度（mm）：50-310

PCB顶部高度（mm）：Max:50

PCB底部限高（mm）：Max:30

全自动PCB板选择性波峰焊传送高度（mm）：900±20

喷涂助焊剂参数：

助焊剂喷涂方式：液柱+喷雾

助焊剂容量：2-4L

喷涂液柱宽度：5-10mm

全自动PCB板选择性波峰焊液柱喷头口径 0.25mm

喷雾宽度：15-30mm

喷雾口径：0.5-1.0mm

预热模块参数：

加热方式：红外线加热

加热功率：Max:2*4Kw

全自动PCB板选择性波峰焊标准预热模组数量：二组分区预热

顶部加热：可选顶部红外加热/每组4Kw

加热温度范围：室温-180

预热温度控制精度： ± 5

焊接参数：

全自动PCB板选择性波峰焊锡炉容量：17Kg/炉*2

锡嘴小直径：直径5mm

波峰高度：3-8mm

锡炉温控： ± 2

焊接温度：Max:300

全自动PCB板选择性波峰焊化锡时间：40分钟260

锡炉加热功率：2.5Kw/炉*2

焊接速度：2-200mm/s

锡氧化量：350g/炉/8小时

焊接精度： ± 0.25 mm

氮气纯度：99.99%

氮气消耗：3立方米/炉/小时

全自动PCB板选择性波峰焊设备参数：

设备外观尺寸(长*宽*高)：2370*1730*1630

电源：3P5W，380VA——50、60Hz

大功率：12Kw

使用功率：6Kw

气源 0.5MPa

排风要求:助焊剂单独排风,焊接区一个排风共2个排风口